



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN23673X

Issue Date:10 Mar 2021

Title of Change:	Transfer of Assembly and Test operations of TO-126 packaged products from ASE WH to Shantou Huashan Electronic Devices Co., Ltd., China (SHEDCL)	
Proposed First Ship date:	16 Jun 2021 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or masitah.aznam@onsemi.com	
PCN Samples Contact: thought	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Jing.Wang2@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Customer may receive parts from SHEDCL once FPCN expired or earlier depending on customer approval. Part from new assembly and test site can be identified through product marking and date code marking which follow ON Semiconductor marking format.	
Change Category:	Assembly Change, Test Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Transfer	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	ASE WEIHAI Inc.	
	SHANTOU HUASHAN Electronic Devices Co., Ltd., China	
Description and Purpose:		
ON Semiconductor wishes to inform our customers of a change in assembly sites and final test sites used for the devices listed in this PCN. All other aspects of the impacted products (form, fit, function) will remain unchanged.		
	Before Change Description	After Change Description
Assembly & Test Site	ASE Weihai	Shantou Huashan Electronic Devices Co., Ltd., China (SHEDCL)
Mold Compound	ST7100KS 48MM X 79G	KTMC3097GXB

**Reliability Data Summary:****QV DEVICE NAME:** KSC5026MOS (PTI : FD)**RMS:** 71699 & 72196**PACKAGE:** TO126 3L AU SNGL PBF

Test	Specification	Condition	Interval	Result		
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj for device, bias = 80% of rated V	1008hrs	0/80	0/80	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device for 1008 hrs	1008hrs	0/80	0/80	0/80
HAST	JESD22 A110	110'C/85%RH for 264 hrs, bias=80% of rated BV, max=100V	264hrs	0/80	0/80	0/80
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000cycle	0/80	0/80	0/80
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C max, Ton=Toff is pkg dependent	15000cycle	0/40	0/40	0/40
UHASt	JESD22 A118	110'C /85%RH for 264 hrs	264hrs	0/80	0/80	0/80
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell	10s	0/30	0/30	0/30
SD	J STD 002	Ta=245C 5 sec dwell	5s	0/15	0/15	0/15

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
KSC5026MOS	KSC5026MOS

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23673X

発行日: 10 Mar 2021

変更件名:	TO-126 パッケージ製品の組立および検査オペレーションを ASE WH から Shantou Huashan Electronic Devices Co., Ltd. (SHEDCL、中国) に移管	
初回出荷予定日:	16 Jun 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < masitah.aznam@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < Jing.Wang2@onsemi.com > にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	お客様は SHEDCL からの製品を、FPCN の期間満了後またはお客様の承認があればその前から受け取ることになります。新しい組立および検査拠点からの製品は、オン・セミコンダクターのマーキングフォーマットに準拠した製品マーキングおよび日付コードマーキングにより識別されます。	
変更カテゴリ: 組立の変更, 検査の変更		
変更サブカテゴリ: 製造拠点の移転		
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
無し	ASE WEIHAI Inc.	
	SHANTOU HUASHAN Electronic Devices Co., Ltd., China	
説明および目的:		
オン・セミコンダクターは、本 FPCN に記載された製品の組立および最終検査拠点の変更をお客様にお知らせいたします。対象製品のその他の特性 (形状、適合性、機能) については変更はありません。		
プロセス	変更前の表記	変更後の表記
組立 & 検査拠点	ASE Weihai	Shantou Huashan Electronic Devices Co., Ltd., China (SHEDCL)
モールド・コンパウンド	ST7100KS 48MM X 79G	KTMC3097GXB



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23673X

発行日: 10 Mar 2021

信頼性データの要約:

デバイス名: KSC5026MOS (PTI : FD)

RMS: 71699 & 72196

パッケージ: TO126 3L AU SNGL PBF

テスト	仕様	条件	間隔	結果		
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj for device, bias = 80% of rated V	1008hrs	0/80	0/80	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device for 1008 hrs	1008hrs	0/80	0/80	0/80
HAST	JESD22 A110	110'C/85%RH for 264 hrs, bias=80% of rated BV, max=100V	264hrs	0/80	0/80	0/80
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000cycle	0/80	0/80	0/80
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C max, Ton=Toff is pkg dependent	15000cycle	0/40	0/40	0/40
UHASt	JESD22 A118	110'C /85%RH for 264 hrs	264hrs	0/80	0/80	0/80
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell	10s	0/30	0/30	0/30
SD	J STD 002	Ta=245C 5 sec dwell	5s	0/15	0/15	0/15

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
KSC5026MOS	KSC5026MOS